

性能特点

- 填料分散性好，界面润湿性好
- 优越的耐高低温、耐高湿性、耐气候性
- 适于丝网印刷、自动点胶等工艺
- 物理化学性能稳定，无腐蚀性

产品描述

PAKCOOL® SPC-5430 导热相变膏是将相变材料和导热填料及其他助剂等进行液 - 液混合，提高导热填料和助剂在相变材料中的分散性，使其具有更加细腻光滑的外观、更好的形态和性能稳定性。该产品是一种含有机硅和可返工的相变材料，应用于发热面和散热面之间的缝隙填充，能有效降低界面热阻，提高散热效率。从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。

另外本产品还具有相变材料的优点，使用过程中不会泵出、变干或渗油，同时还具导热硅脂的可靠性和易操作性，此产品专为丝网印刷而配制，不适用于在线点胶工艺。

典型应用

- 微处理器
- 芯片模块
- 集成电路
- IGBTs
- 电子应用中的主动散热装置

注意事项

- 本产品有一定挥发性，使用时需做好防护并保持使用环境通风。
- 产品粘度不同温度下有一定差异，建议客户在恒温条件下使用。
- 如客户需要更详细的说明，请与我公司市场销售部联系。他们会随时为您解答和服务。

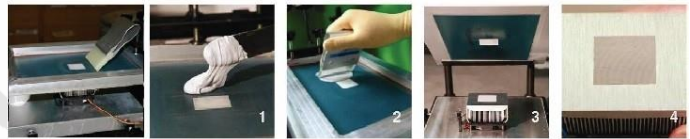
技术参数

特性	SPC-5430	测试方法
外观	灰色膏状	目测
相变温度 (°C)	44±2	DSC
粘度(cP)	20-40 万	ASTM D2196-15
导热系数 (W/m·k)	>3.0	ASTM D5470
热阻 (K-inch ² /W @20psi)	≤0.01	ASTM D5470
BLT(um)	≤15	ASTM D5470
密度(g/cm ³)	2.82±0.02	ASTM D792
使用温度 (°C)	-40~+150	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

使用方法

- 丝网印刷工艺，方法如下图所示：



- 丝网的材料一般是尼龙，涂覆的厚度与丝网的目数有关，目数越小，丝网的直径就越大，在同样的印刷条件下，涂覆的厚度也就越厚。

典型干燥条件

0.250 mm Thickness:	
25°C	48h
70°C	60min
150°C	10 min

以上干燥条件仅做为使用指导，实际的温度和时间还需要客户根据自身的烘箱条件确定。

包装储运

- 本产品可提供 55mL 支装，330mL 胶瓶，1Kg 罐装，5Kg 和 20Kg 的桶装，或根据客户要求定制包装。
- 本产品为无毒、不燃材料，罐/桶装产品在 2°C - 8°C 下的储存期为 12 个月。产品使用前应在 25°C 或使用环境温度下回温至少 4 小时，使胶料温度与使用环境温度一致后再使用。

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。